# 新产品测试规

产品开发测试规范

1.0目的统一测试项目及相应的测试标准。

2.0适用范围技术部开发设计阶段的产品测试。

3.0职责技术部工作技术人员均需按本规范对开发产品进行测试验证。

4.0规范内容

4.1 工艺检验

1.1.1 机构要求主要看电池的外观，尺寸，

以及规格是否满足设计要求。

具体的标准可参照机构相关规范要求

1.2.1 PCBA设计要求

1．温度Senser的位置要紧贴被测元器件并保证热传导良好；

2．镍片不能有毛刺，不能有刺穿电芯和导线的可能；

3PCB

板的布局要合理，要方便生产测试；

4．各个电芯上连线的焊接点要贴麦拉绝缘；

5PCB板与电芯之间要有足够的安全距离；

6板上朝向电芯的面，不得有任何尖刺；

7．焊接的线材焊点要点胶；

8PCB位置要固定，不能摇动；

9结构件不能直接接触板上的元件，之间要有足够的安全距离。